

Capabilitylist



Leverancier van Printplaten
Kennis Openbaart Vakkundige Oplossingen

1. Materialen en laminaten	Capability	Tolerantie / leverancier / Opmerking
- printplaatdikte		
enkel- en dubbelzijdig	0.15 – 6,35 mm	+/- 10%
multiLayer	0.30 – 6.35 mm (up to 42 Layers)	+/- 10%
flex	0,089 mm ~ 0,200 mm	+/- 10%
- koper dikte		
buitenlagen minimaal	5 µm	+/- 5%
buitenlagen maximaal	350 µm	+/- 5%
binnenlagen minimaal	5 µm	+/- 5%
binnenlagen maximaal	105 µm	+/- 5%
- materiaal soort	FR4 serie, Rogers 4000 serie	Isola, Guangdong, Nanya, Tuc, Iteq, Rogers,
- materiaal hoge Tg	FR410, IS410, FR408, IS420, Polyclad 370HR, Polyimide	Isola, Rogers, Getec, Arlon 85N, Taconic, Nelco, etc.
- materiaal hoge temperatuur bestendigheid	FR4 DE117 , Teflon / BT	Isola Duraver, Rogers
- flex	Polyimide	Du-pont polyimide thinflex series
- metalcore	Aluminium (all thickness)	CS-AL-68, CCAF-01, SMI CCI Eurolam
2. Boren		
- min. gat diam. (Mech)	0.2 mm (PTH)	+/- 0.025mm, Depends on Board-Thickness
- min. gat diam. (Laser drilled)	0,089 mm (PTH)	+/- 0.127mm, Depends on Board-Thickness
- min. afstand tussen de gaten	0.3 mm	
- min. Annular Ring	0.1 mm	
- positionering afwijking	+ / – 0.030 mm	
3. Spoor-eiland patroon		
- min. spoorbreedte	0,07 mm	+ / – 20%
- min. isolatieafstand	0,07 mm	+ / – 20%
4. Plating specs		
- min. koper (External plating) in de gaten	20µm - 25µm	Aspect ratio 20 : 1
5. Eilandbedekking (finish)		
- chemisch nikkel+goud	0,5µm Ni + 0.05 - 0,1µm Au	Voor loodvrij solderen, voor alum wire bounding en touch pads
- immersion goud (boundable)	3-5µm Ni + 0,1µm Au 0.2 – 0.3µm	
- immersion zilver	0.15 – 0.5µm	
- OSP	0.2 – 0.5µm	

- immersion Sn	0.8 – 1.2µm	
- galvanisch nikkel plating	3µm - 12,7µm	Edge connector contacten
- galvanisch goud plating	1.25 – 1,5µm	Edge connector contacten
- Hard-Goud	5,0µm Ni + 1,25µm Au	Volledige printplaat, frictie/druk contacten
- ENEPIG (Electroless Nickel Electroless Palladium Immersion Gold)	electroless nikkel (3-5µm) en electroless palladium (0,2-0,5µm) en immersion gold (0,05-0,07µm)	Volledige printplaat, goed soldeerbaar, geschikt voor wirebonden van gouddraden en aluminiumdraden maar ook geschikt als contact oppervlak
- loodvrij HAL	5 – 15µm	Voor loodvrij solderen
- karbon Ink / Entek		
6. Legend / silkscreen		
- min. Tekst hoogte	70 mils, 0.5 mm	
- min. Tekst dikte	5 ~ 7 mils, 0,127 ~ 0,178 mm	
- min. Tekst Spacing	5 ~ 7 mils, 0,127 ~ 0,178 mm	
7.Soldeermasker		
- min. SM Clearance	0,05mm	
- dikte	0.015 mm ~ 0,05 mm	
- kleur	Blauw / Groen / Zwart / geel / Red / wit	
8. Mechnisch		
- maximale printplaat afmetingen	1100 X 635 mm	+ / – 0.1 mm
- aantal lagen	42	Depends on total Thickness
- afschuinhoek	30° ~ 45°	
- contour	Frezen, v-groeven, lasersnijden	+/- 0.05mm
9. Electronisch testen		
- onderbrekingen / Sluitingen	Ja	
- leakage	Ja	
- flying Probe	Ja	
- pennen bed	Ja	
10. Impedance Control		
- pre-calculating + testcoupon	50 Ohm, 75 Ohm, 100 Ohm, ...	+/- 10% standaard of +/- 5% advanced
11. Cross-section + Rapport	Ja	
12. Conformance to IPC rules	Ja	
13. RoHS Compliance	ja	
14. Via Technology		
- plugged via	ja	
- blind en buried via	Ja	0.1mm: aspect ratio 4:1, 0.2mm: aspect ratio 8:1
- kopergevulde, plated and finished	Ja	

- Laser drilled via in pad constructie	Ja
---	----

Om zonder vertraging met uw order te kunnen beginnen, hebben we van u nodig:

1. Gerber RS-274 D, Gerber RS274-X, ODB++, DPF, IPC-2581, DXF-data of Eagle voor alle artwork Layers
2. Aperture-lijst (geldt alleen voor GerberRS-274 D)
3. Boorfile in Gerberformaat of Excellon of een ander formaat (Wessel, Sieb und Meyer, Posalux,.....)
4. Boordiameter-tabel (tool-tabel) met plated en niet-plated gaten
5. Omschrijving: pcb-dikte, pcb-materiaal, soort finishing, millingdata voor pcb-contour en cut-outs.
6. Eventueel speciale opmerkingen of "Read Me" met:
 - kleur en type soldeermasker
 - kleur silkscreen
 - plating dikte voor koper, nikkel en goud
 - laagopbouw specificatie (gedetailleerd indien blind and buried vias)
 - Controlled Impedance eisen en toleranties
 - eventueel andere specificaties